

2013.5-10 日刊工業

新日本テックの「超薄型多結晶ダイヤモンド」

**優秀賞**

**独創技術ここに結実**

第25回 中小企業優秀新技術・新製品賞

りそな中小企業振興財団・日刊工業新聞社選定 **6**

オーキヤは導電シリコンラバーと、薄膜電極

**優秀賞**

**超薄型PCD  
ダイシングブレード  
新日本テック**

(PCD)ダイシングブレードは次世代LSIのダイシング(チップ切断)品質を向上する技術。熊本大学や大阪府立産業技術総合研究所などと共同で開発した。紫外光励起研磨で、PCDの全周を厚さ10μm(マイクロは100万分の1)前後まで尖鋭化し、薄型の脆性材料に対応。0.05mm以下の薄

**割れや熱損傷抑える**



型ウエハー加工で従来、課題だった割れやチップ

制した。次世代半導体に用いる炭化ケイ素(SiC)やサファイア基板の高精度ダイシングが可能。高価なレーザー設備を導入する必要があったこれらの加工をアレードマシンで対応できるようにした。

(大阪市鶴見区、和泉康夫社長、06・6911・1183)

